

SEML

湘南ボンディングセンター

2013年1月
拡大移転!!



- 床面積 **1,000 m²**
- 対応寸法 最長 **3,000 mm** 順次拡大
- 処理能力 最大 **200 m²/月**
- 高度なセラミクスボンディング技術
湘南電子材料研究所における30年間、数百種類に及ぶセラミクスボンディング技術を最大限に活用
- スtockシステム採用
ターゲット・バックングプレートをお預かりし、管理業務を軽減・納期短縮

管理コスト軽減!

主要設備

- ・ホットプレート
- ・超音波探傷機
- ・サンドブラスト
- ・クリーンブース
- ・真空梱包機

ターゲット・ボンディングに関わるあらゆるご相談をお受けいたします

- ターゲット追加工
- 短納期対応

- バックングプレート製作
- ターゲット製造

SEML 沿革

当社は1980年にスパッタリングターゲット、EB蒸着材料の開発・製造・販売を目的に創業いたしました。

以降現在に至るまで、セラミクスを中心とする製品を手掛け、In₂O₃系・ZnO系をはじめとする高機能性材料の蒸着材・ターゲットを開発販売。薄膜材料を幅広く製造するメーカーとして、多くのお客さまのご満足に向けた高機能薄膜の進化のお手伝いをしています。

SEML

株式会社湘南電子材料研究所



湘南ボンディングセンター

所在地 〒259-1302
神奈川県秦野市菩提 3-1

株式会社湘南電子材料研究所



所在地 〒257-0031
神奈川県秦野市曾屋 741-1
電話 TEL0463 (82) 7711 FAX0463 (82) 8091

>> お問い合わせ
開設準備室



電話

0463-82-7711 (営業 木村 / 加藤)



メール

seml@seml.co.jp